

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. November 2005 (10.11.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/107342 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H05K 1/00,
1/11, 3/40, 3/42

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050919

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. März 2005 (02.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 021 062.4 29. April 2004 (29.04.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUSCH, Georg
[DE/DE]; Feldmark 5, 48683 Ahaus (DE).

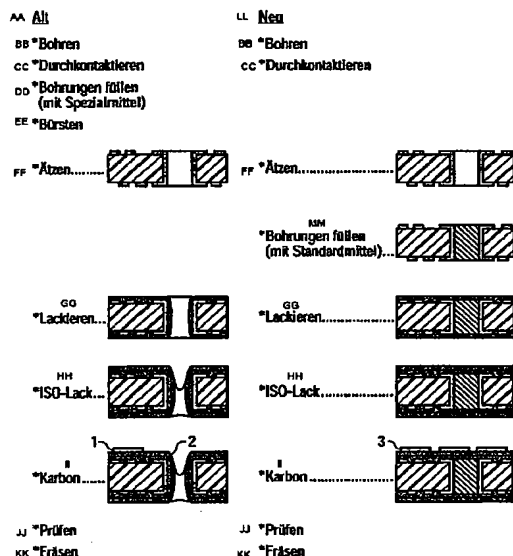
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AF, AG, AI.,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF CIRCUIT BOARDS AND/OR CORRESPONDING CONSTRUCTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITERPLATTEN UND/ODER ENTSPRECHENDEN KON-
STRUKTEN



AA... PRIOR ART
BB... DRILL
CC... CONNECT THROUGH
DD... FILL BORES (WITH SPECIAL SUBSTANCE)
EE... BRUSH
FF... ETCH
GG... LACQUER
HH... ISO-LACQUER
II... CARBON
JJ... TEST
KK... MILL
LL... INVENTION
MM... FILL BORES (WITH STANDARD SUBSTANCE)

(57) Abstract: Disclosed is a simplified, inexpensive method for
producing printed circuit boards and/or corresponding constructs
comprising points where through-connections are created. Such
a method dispenses with the need for a very complex brushing
process while using exclusively low-cost lacquer variants. More-
over, the inventive method allows additional strip conductors or ap-
propriate layers to be guided even directly across the through-con-
nections rather than just to said through-connections..

(57) Zusammenfassung: Es wird ein vereinfachtes, kosten-
günstiges Verfahren zur Her- stellung von Leiterplatten und/oder
entsprechenden Konstruk- ten vorgeschlagen, welche Stellen
aufweisen, an denen Durch- kontaktierungen realisiert sind.
Ein solches Verfahren ver- zichtet auf einen sehr aufwendigen
Bürstvorgang und verwendet ausschliesslich kostengünstige
Lackvarianten. Trotzdem wird zusätzlich erreicht, dass weitere
Leiterbahnen oder entspre- chende Schichten nicht nur bis zu
den Durchkontaktierungen sondern ohne weiteres sogar direkt
darüber hinweg geführt werden können.

WO 2005/107342 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.